

KLA, 새로운 IC 계측 시스템 출시

고성능 로직과 메모리 칩 제조 가능

밀피타스, 캘리포니아, 2020년 2월 24일/PRNewswire/- [KLA Corporation](#) (NASDAQ: KLAC)은 오늘 집적회로("IC" 또는 "칩") 제조를 위한 Archer™ 750 이미징 기반 오버레이 계측 시스템과 SpectraShape™ 11k 광학 임계치수(Critical Dimension, "CD")를 선보였다. Archer 750은 칩의 각 레이어가 구성됨에 따라 패턴 형상이 이전 층의 형상과 제대로 정렬이 되는지 검증하며, SpectraShape 11k는 트랜지스터와 메모리 셀 등의 3D 구조를 모니터링하여 스펙이 충족을 지원한다. 해당 신규 계측 시스템은 패턴 정렬 또는 형상의 미세한 차이를 파악하여 IC 제조업체들이 5G, AI, 데이터 센터 및 엣지 컴퓨팅 등의 애플리케이션에서 사용되는 고성능 메모리 및 로직 칩을 시장에 출시함에 있어서 요구되는 복잡한 공정을 엄격하게 제어한다.

KLA의 계측 부서의 Sr.VP/ GM인 Jon Madsen은 "첨단 칩에 새로운 구조와 신규 물질이 접목되면서 IC 업체들은 원자 단위에서 측정을 해야 하는 공정 허용 범위에 직면해 있습니다." 라고 언급하면서 다음과 같이 발표했다. "KLA는 이러한 칩을 고품질표준으로 비용 효율적으로 생산되도록 하는데 있어서 중요한 역할을 합니다. 오늘 당사의 포트폴리오에 추가되는 2개의 계측 솔루션을 발표하게 되어 영광입니다. 이는 다양한 팀에서 근무하는 최고의 엔지니어 및 과학자들의 노력과 창의적인 사고의 결실입니다. 새로운 SpectraShape 11k와 Archer 750 시스템은 Fab 고객들이 필요로 하는 공정 제어 역량을 제공하며 고객들이 세계를 발전시킬 수 있는 혁신적인 전자제품을 생산하도록 지원합니다."

Archer 750 오버레이 계측 시스템은 공정 변동이 존재하는 상황에서 오버레이 오류를 정확하고 견고하게 측정함과 동시에 이전에는 산란계측 기반의 오버레이 시스템에서만 가능했던 생산성 수준을 달성한다. 이 혁신적인 시스템은 다양한 층에서 신속하고 정확한 피드백을 제공하여 사진 식각 엔지니어들이 첨단 로직, DRAM 및 3D NAND 소자의 안정적인 생산과 빠른 수율 개선을 실현하도록 인라인에서 공정 이탈점을 파악하고 전반적인 패터닝 완성도를 향상시키는 작업을 지원한다.

SpectraShape 11k CD 및 차원 형상 계측 시스템은 감도와 생산성을 유례없는 수준으로 조합해서 이전에는 접근 불가능했던 웨이퍼 형상, 구조 및 소재를 지원한다. 첨단 로직, DRAM 및 3D NAND 소자 형상을 고정밀도와 높은 속도로 측정할 수 있는 역량을 보유한 SpectraShape 11k는 공정 문제를 빠르게 파악하고 생산 가동 중 공정을 엄격히 모니터링을 가능하게 한다.

성능을 개선해주는 신규 계측 시스템 및 기술 개발에 대한 세부 사항은 [포트폴리오 정보 페이지](#)에서 볼 수 있다.

Archer 750와 SpectraShape 11k 시스템은 세계적인 선도 IC 제조업체의 인증을 거쳐 가동 중이며 혁신적인 전자 소자를 생산하는 다수의 공정 단계에서 중대한 영향을 미칠 수 있는 피드백을 제공한다.

Archer 750 와 SpectraShape 11k 는 실시간 공정 제어와 엔지니어링 모니터링 분석을 지원하는 KLA 의 5D Analyzer® 첨단 데이터 분석 시스템과 결합해서 사용된다. Archer 750 와 SpectraShape 11k 계측 시스템은 칩 제조업체들이 요구하는 높은 수준의 성능과 생산성을 유지하기 위해 KLA 의 글로벌 종합 서비스 네트워크를 활용하고 있다.

KLA 개요:

KLA 는 전자 산업에 걸쳐 혁신을 추구하는 산업을 선도하는 장비와 서비스를 개발한다. 당사는 제조 웨이퍼와 레티클, 집적 회로, 패키징, 인쇄회로 기판과 평면 디스플레이를 위한 첨단 공정 제어 역량과 공정을 실현하는 솔루션을 제공한다. 세계 곳곳에서 선도 고객사와 긴밀히 협력하는 물리학자, 엔지니어, 데이터 과학자 및 문제해결사들로 이뤄진 당사의 전문가 팀은 세계를 발전시키는 솔루션을 설계한다. 세부 정보는 www.kla.com 에 명시돼 있다 (KLAC-P)

미래지향적 진술서:

칩 제조 시설, 소재, 장비 및 웨이퍼를 위한 계측 측정 값의 경제적 효과와 Archer 750 및 SpectraShape 11k 시스템의 기대 성능과 관련된 진술서 등의 역사적 사실 외의 해당 보도 자료에 명시된 진술서는 미래지향적 진술서이며 1995 년 민사증권소송개혁법에서 제정된 세이프 하버 조항을 준수한다. 해당 미래지향적 진술서는 현재의 정보와 예상에 기인하며 위험요인과 불확실성을 포함한다. KLA 제품의 사용, 성능 또는 실현에 영향을 미치는 제약사항, 예상치 못한 기술적 어려움, 타사의 경쟁제품 도입, 또는 (비용, 성능 또는 기타 이슈로 인한) 신규 기술 채용 지연을 포함하는 다양한 요인으로 인해 해당 진술서에 전망된 값은 실제 값과 상이할 수 있다.

투자활동(IR): Kevin Kessel, CFA, Vice President, 투자활동(IR), (408) 875-6627, kevin.kessel@kla.com;

미디어 활동: Randi Polanich, 최고 커뮤니케이션 책임자, (408) 875-6633, randi.polanich@kla.com